

# CC800<sup>®</sup> HiPIMS

HiPIMS - 高出力・インパルス・マグネトロン・スパッタリング



コーティング範囲、 $\phi \times h$	[mm]	$\phi 400 \times 400$
治具テーブル、 $\phi \times \phi$ ターンテーブル x 構成数	[mm], piece	$\phi 400 \times \phi 130 \times 6$
カソードサイズ	piece, [mm]	6 x 500 (4つのHiPIMS/DC両用カソードと2つのDC専用カソード、全カソードにシャッターを設備)
最大積載寸法、 $\phi \times h$	[mm]	$\phi 400 \times 800$
処理容量、ドリル、 $\phi 6 \text{ mm} \times 60 \text{ mm}$	piece	1,800
処理容量、インサート、 $12,7 \text{ mm} \times 3,5 \text{ mm}$	piece	4,920
最大積載重量	[kg]	250
成膜速度	$\mu\text{m/h}$	2 $\mu\text{m/h}$ in pure HiPIMSモード
サイクルタイム(3 $\mu\text{m}$ FerroCon <sup>®*</sup> の場合)	[h]	4.5
プロセス		HiPIMSとブースター技術を利用したスパッタリング、CemeConの主要なコーティングは全て処理可能
前処理方式 (プラズマエッチング)		ブースター、MF及びHiPIMSエッチング
伝導性コーティングの成膜可否		可能
非伝導性コーティングの成膜可否		可能
非伝導性基材への成膜可否		可能
定格出力	[kW]	80
1パッチ当たりの消費電力 (3 $\mu\text{m}$ FerroCon <sup>®*</sup> の場合)	[kWh]	120
外形寸法 (w x l x h)	[mm <sup>3</sup> ]	1,450 x 3,350 x 2,200

\* フルロード、3回転の10mmフライスカッターでの純HiPIMSコーティング